

# 2016ワークショップ 開催案内

## IoT社会を先取りする先進実装

～ 実装のあらたな役割を探る ～



2016年10月13日(木)～14日(金)  
ラフォーレ修善寺 研修センター にて開催

協賛…応用物理学会、スマートプロセス学会、化学工学会、高分子学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本画像学会、日本機械学会、日本伝熱学会、日本電子回路工業会、溶接学会、アメリカ機械学会日本支部

エレクトロニクス実装学会では、実装技術に関するワークショップを、10月13日(木)～14日(金)の2日間、ラフォーレ修善寺(静岡県伊豆市) 研修センターにて開催いたします。

『IoT社会を先取りする先進実装 ～実装のあらたな役割を探る～』というテーマを掲げ、以下のような魅力的なプログラムを予定しております。

1. 招待講演 : 坂上 義秋 様 ( 株本田技術研究所 ) による  
『自動運転技術動向とシステムアーキテクチャの今後』
2. ナイトセッション講演 : 國廣 愛彦 様 ( 株フルハートジャパン ) による 『下町ボブスレー』
3. ミッションフェロー(MF)活動紹介 (ポスター形式)  
\*MF…2014.4月に発足した若手中心のタスクチームで、JIEPに新風を吹き込むべく活動中です。
4. ポスター発表

52件、分野…実装材料、プロセス、プリンタブル、車載、ヘルスケア、パワエレ、IoTなど

このワークショップでは、通常の講演会や学会とは異なり、ポスターの前で発表者と参加者が一体となり、双方向のディスカッションを中心に行います。2日間にわたる熱い議論の中から、課題解決へのヒントや将来の夢、新たな問題提起や異分野の方々とのネットワーク構築等々、多くの成果を必ずやお持ち帰りいただけるものと確信しております。詳細情報は、準備出来次第、学会ホームページ (<http://www.e-jisso.jp/>) に掲載いたします。

2016ワークショップ実行委員会 委員長 子林 みどり (新川)

### 費用・申込方法

申し込み: 8月上旬に当学会ホームページに申込リンク先を設定いたします。

参加費用: 正会員・賛助会員: ¥45,000、協賛団体会員: ¥54,000、一般: ¥55,000、学生: ¥35,000  
(宿泊費、食事、消費税を含みます。\*なお一般の方は、同時に学会にご入会いただくと、初年度のみ年会費半額で、かつ今回のワークショップに会員扱いでご参加いただけます。)

申込締切: 9月28日(水) (ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。)

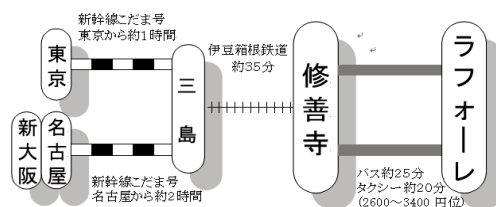
定員: 100名(先着申込順)

支払方法: 請求書到着後、銀行振込にて。お申込み後のキャンセルはできません。

申込先: (一社) エレクトロニクス実装学会 ワークショップ(修善寺)係

問合せ先: 〒167-0042 東京都杉並区西荻窪北 3-12-2, Tel:03-5310-2010,  
Email: 2016ws@jiep.or.jp

### アクセス



### スケジュール

10月13日(木)		10月14日(金)	
13:00～	登録開始	07:30～08:30	朝食
13:30～14:00	オリエンテーション	09:00～	2日目セッション開始
14:00～15:00	第1セッション(アブストラクトトーク)	09:30～10:30	第3セッション(アブストラクトトーク)
15:00～17:40	第1セッション(ポスター)	10:30～11:50	第3セッション(ポスター前半)
18:30～20:00	夕食(立食形式懇親会)	11:50～12:30	昼食
20:30～21:30	ナイトセッション講演	12:30～13:50	第3セッション(ポスター後半)
21:30～	第2セッション(自由討論)	13:55～14:55	招待講演
	就寝	15:00～	アンケート・閉会式・現地解散

プログラム

招待講演 : 『自動運転技術動向とシステムアーキテクチャの今後』 坂上 義秋/本田技術研究所  
 ナイトセッション : 『下町ボブスレー』 國廣 愛彦/フルハートジャパン

(敬称略)

10月13日(木)		10月14日(金)	
実装関連材料	1. 次世代FO-WLP向け超厚膜めっき用レジストの開発 佐藤 慶一/JSR	実装関連材料	27. 環境負荷を軽減したエポキシ系接着剤の開発 後藤 雅治/ADEKA
	2. ビルドアップ基板のビアホールにおけるフォトデスマアの適用性 饗庭 彰/ウシオ電機		28. 半導体パッケージ用ソルダーレジストの信頼性向上に関する検討 椎名 桃子/太陽インキ製造
	3. 高耐食性無電解Ni/Auめっきプロセス「ICP」コソソHFP/フッソ「コート」 330H 瀬戸 寛生/奥野製薬工業		29. 自己析出型コーティングの銅素材への適用 春木 美穂/日本パーカライジング
	4. 銀めっき皮膜の耐変色性 吉田 宗典/三ツ矢		30. 放熱性とはんだ接続信頼性に優れた実装基板コーティング材の開発 伊藤 真紀/日立製作所
3D・光・最先端PKG	5. PBWによる高分子材料への機能構造の形成 林 秀臣/芝浦工業大学	3D・光・最先端PKG	31. システムにおける光実装の現状と課題 平 洋一/慶應義塾大学
	6. Sn-Ag系薄膜接合による3D-IC実装プロセスに関する研究 岩田 剛治/大阪大学		32. エクサスケール2.5/3次元集積化のための新しいハイブリッドボンディング 技術 李 康旭/東北大学
	7. PLP技術を用いたワンパッケージ高密度実装の取り組み 田澤 雅也/ジェイデバイス		33. 3次元実装のためのCu-TSV抵抗率測定方法とCu結晶 佐藤 明/日立パワーソリューションズ
	8. 新規FO-WLPの工程を考慮した低反り材料 濱口 宏治/日立化成		34. モジュール型汎用自動組立装置SmartFABによる3D-MID実装の ご紹介 市野 慎次/富士機械製造
プロセス・接合技術・装置	9. Injection Molded Solder法を用いた微細バンパ形成技術 中村 英司/日本アイ・ピー・エム	プロセス・接合技術・装置	35. Cuナノ粒子接合の信頼性に及ぼす熱膨張係数差の影響 三浦 大貴/大同大学
	10. 半導体デバイスへの適用が広がる コンプレッションモールド技術 水間 敬太/TOWA		36. TCB工法を用いたCoW実装における熱挙動解析 朝日 昇/東レエンジニアリング
	11. アルミ線はんだ接合部のポイド率低減策の検討 山崎 浩次/三菱電機		37. 高生産性TCBプロセスに向けた一括接合用フィルム 小関 裕太/日立化成
	12. 狭ピッチラージダイの有機インターポーザへのフリップチップ実装 大竹 智史/新光電気工業		38. ステルダイシング技術の最新動向 坂本 剛志/浜松ホトニクス
13. 新たなデバイスに対応する高付加価値実装装置の紹介 萩原 泰三/神港精機	39.		
評価・信頼性	14. 銀焼結接合と金属-セラミック絶縁基板の信頼性 結城 整哉/DOWAホールディングス	評価・信頼性	40. 外部応力型ウィスカ対策合金被膜の検討 岩本 博之/千住金属工業
	15. 無電解Ni/Pd/Auめっきにおけるはんだボール接続信頼性-無電解Pd めっき膜厚の影響- 江尻 芳則/日立化成		41. 金属イオン拡散を抑制する高信頼性半導体材料の開発と拡散抑制機構 の検証 中山 紀行/日立化成
	16. LEDランプの軽量化のための放熱設計手法 井岡 久美子/東芝		42. 赤外線サーモグラフィのピーク検出能力向上の試み 平沢 浩一/K O A
	17. ラマン分光法を用いたSiCパッケージの応力の定量評価 内田 智之/東レリサーチセンター		43. モバイル機器の熱伝達関数モデリングによる筐体表面温度管理の精度 向上 石井 雅俊/富士通研究所
IoT/センシング	18. 道路インフラモニタリングシステムとセンサ端末実装技術の開発 原田 武/NMEMS技術研究機構	IoT/センシング	44. IoTの最前線! トリオン (1兆個) センサ - 見えない価値の可視化 技術- 寺崎 正/産業技術総合研究所
	19. 高性能センサーアレイのための高歩留まり・ピアラストTSVプロセス 渡辺 直也/産業技術総合研究所		45. 印刷で作るそれとない見守りのためのフィルム人感センサ 野村 健一/産業技術総合研究所
	20. トリオン・センサ社会に向けた MEMSセンサ製造技術 金尾 寛人/S P Pテクノロジーズ		46. 機能性マイクロ粒子の誘電泳動を用いた高次ナノ構造形成と微量分子 検出 福岡 隆夫/兵庫県立大学
ウェアラブル・プリンタブル	21. メガネ型計測デバイスJINS MEMEの開発と活用事例 上間 裕二/ジェイアイエヌ	ウェアラブル・プリンタブル	47. デバイス調和型の接続・実装技術の開発とその応用 三井 亮介/日本航空電子工業
	22. プリントドエレクトロニクスで実現する新たなモノづくり 平松 賢太/SCREENホールディングス		48. 低温プラズマ焼結による銅ナノ粒子のバルク化 白川 直樹/産業技術総合研究所
	23. 柔軟なドライ電極を用いた生体信号計測 (仮題) 井上 雅博/群馬大学		49. 硬く高機能な材料を用いた柔軟フレキシブルデバイスの実現 岩瀬 英治/早稲田大学
ハリス	24. 内視鏡手術におけるエネルギー処置具への高効率無線給電技術の提案 鶴田 尚栄/オリンパス	ハリス	50. パワーモジュールの高信頼性化に向けたCuコネクタ接続手法の検討 川城 史義/東芝
パワエレ・カーエ	25. SiCパワーモジュールのための高温過渡熱解析による熱抵抗評価 加藤 史樹/産業技術総合研究所	パワエレ・カーエ	51. HVパワーモジュール向けNi-Pめっき/Sn-0.7Cuはんだ接合界面の 高耐熱化技術 門口 卓矢/トヨタ自動車
	26. 高熱伝導グラファイトのパワー半導体モジュール放熱板への適用可能性 山田 靖/大同大学		52. カーエレクトロニクスを支える半導体パッケージ技術 今村 武史/ジェイデバイス

ミッションフェロー活動紹介

ワークショップ2016実行委員会: 委員長: 子林みどり(新川) 副委員長: 島津貴之(住友電工) 実行委員: 坪井一彦(コニカミルタ) 塚野 純(コニカミルタ)  
 山道新太郎(日本IBM) 滝澤 稔(東芝) 笹岡達雄(パナソニック) アドバイザリ: 西 真一(コニカミルタ) 齊藤雅之(東芝)

## 招待講演

坂上 義秋 様 (株)本田技術研究所) による  
『自動運転技術動向とシステムアーキテクチャの今後』



自動運転車「AUTOMATED DRIVE(オートメテッドドライブ)」

## ナイトセッション

國廣 愛彦 様 (株)フルハートジャパン) による  
『下町ボブスレー』

